



证券代码：002213

证券简称：大为股份

公告编号：2022-012

## 深圳市大为创新科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司全资子公司芯汇群科技香港有限公司（以下简称“芯汇群香港”）的通知，芯汇群香港对其董事及注册地址进行了变更，并已取得了香港特别行政区公司注册处换发的《商业登记证》，具体变更情况如下：

企业名称	变更事项	变更前	变更后
芯汇群科技香港有限公司	董事	张武贤	连浩臻
	注册地址	RM 1450, 14/F ETON TOWER 8 HYSAN AVENUE CAUSEWAY BAY HK	19H MAXGRAND PLAZA NO.3 TAI YAU STREET SAN PO KONG KL

变更后的《商业登记证》基本信息如下：

- 1、公司名称：芯汇群科技香港有限公司  
英文名称：SXMICRO TECHNOLOGY HK LIMITED
- 2、注册地址：19H MAXGRAND PLAZA NO.3 TAI YAU STREET SAN PO KONG KL
- 3、注册资本：1,000,000 美元
- 4、经营范围：电子产品及技术的研发、销售、贸易、进出口业务
- 5、商业登记证号码：72779659-000-03-22-0

除上述变更外，芯汇群香港工商登记的其他事项未发生变化。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董 事 会

2022年3月10日